

銅上の無電解パラジウム／金めっきプロセス

Electroless Pd/Au Plating Process on Cu

トップパラスNプロセス

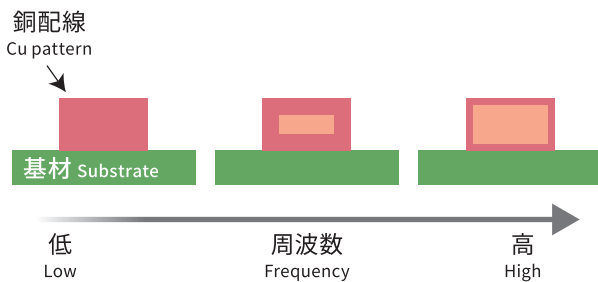
TOP PALLAS N PROCESS

- ニッケルレスのため高周波特性に優れる
Ni-less type process to use under high frequency
- はんだ接合性、金ワイヤボンディング性に優れる
Excellent in solder joint, gold wire bonding performance
- 耐折性、耐食性が良好
High folding endurance, great corrosion resistance
- ファインパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability

高周波特性に対応 Can use for high frequency property

周波数が高くなるにつれ、電流は表面に近いところ(赤い部分)を流れる(表皮効果)

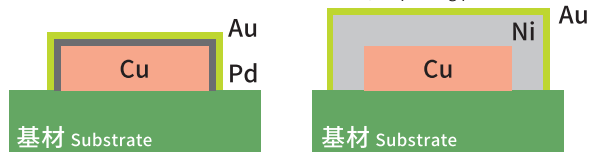
Under high frequency, electric current flows on areas near surface



抵抗値の高いNi-P皮膜を無くすことで、伝送損失を大幅に低減

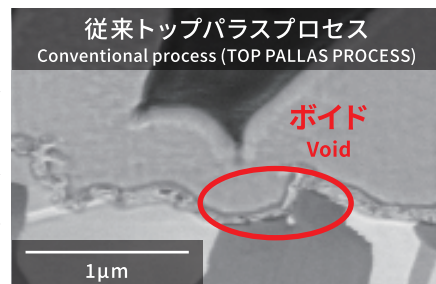
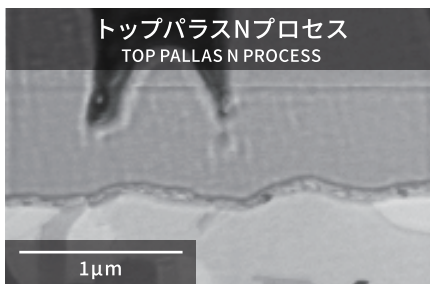
Transmission loss can decrease significantly because Ni-P (Electric resistance: high) becomes unnecessary

トップパラスNプロセス 従来無電解Ni/Auプロセス
TOP PALLAS N PROCESS Conventional electroless Ni/Au plating process

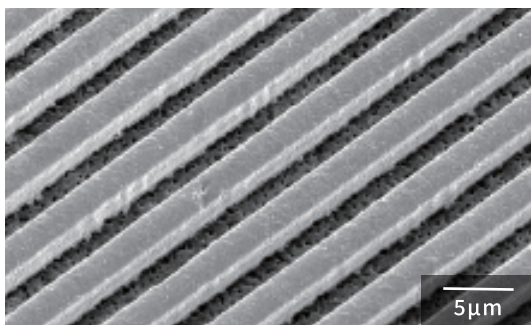


	Cu	Ni-P	Pd	Au
電気抵抗値($\mu\Omega\text{cm}$) Electric resistance	1.7	60.0	10.8	2.5

優れたはんだ接合性 Excellent in solder joint performance



ファインパターン性に優れる Excellent in fine pattern ability

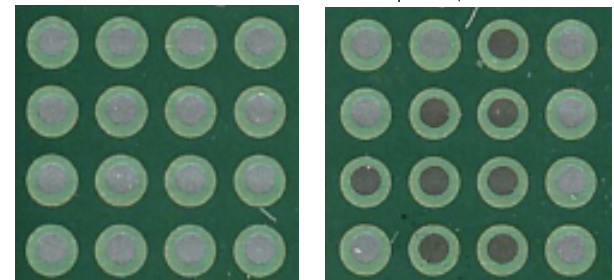


L/S=3/3 μm

パラジウム析出性が良好

High deposition ability of palladium plating

トップパラスNプロセス 従来トップパラスプロセス
TOP PALLAS N PROCESS Conventional process (TOP PALLAS PROCESS)



パラジウムめっき液に銅が混入(10ppm)した際のめっき析出性
Deposition performance when 10 ppm of copper is dragged into palladium plating bath

※基板パッド径:500 μm
Pad diameter of substrate